

化学

金属离子配位作用对槲皮素模板聚合物性能的影响

刘鹏, 邓书端, 卢桂英, 丁中涛, 曹秋娥

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

**摘要** 采用槲皮素及槲皮素与Cu(II)和Co(II)的配合物为模板分子, 丙烯酰胺(AM)为功能单体, 在甲醇中制备了一系列印迹聚合物和非印迹聚合物, 并用平衡结合实验研究了聚合物的性能, 探讨了金属离子的引入对槲皮素印迹聚合物吸附性能的影响. 结果表明, 在印迹聚合物的聚合体系中引入金属离子Cu(II)和Co(II), 尤其是Co(II)后, 印迹聚合物对槲皮素的吸附容量和印迹效果均有明显增加; 同时如果在吸附溶液中再加入金属离子, 印迹聚合物的吸附容量可以由未加金属离子时的35.99mg/g增加到69.10mg/g, 印迹因子则由1.68增加到了1.94.

**关键词** [印迹聚合物](#); [槲皮素](#); [铜\(II\)](#); [钴Co\(II\)](#) [金属配位作用](#)

分类号

**DOI:**

通讯作者:

作者个人主页: [刘鹏](#); [邓书端](#); [卢桂英](#); [丁中涛](#); [曹秋娥](#)

## 扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [PDF](#) (952KB)
- ▶ [\[HTML全文\]](#) (0KB)
- ▶ [参考文献\[PDF\]](#)
- ▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [引用本文](#)
- ▶ [Email Alert](#)

相关信息

- ▶ [本刊中 包含“印迹聚合物; 槲皮素; 铜\(II\); 钴Co\(II\)” 的相关文章](#)
- ▶ 本文作者相关文章
  - [刘鹏](#)
  - [邓书端](#)
  - [卢桂英](#)
  - [丁中涛](#)
  - [曹秋娥](#)